

6616



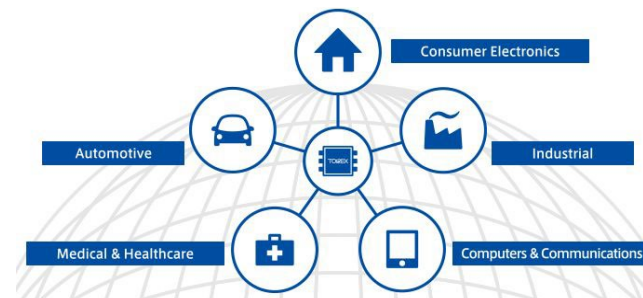
# 2025年3月期 第1四半期 決算説明資料

2024年 8月9日

トレックス・セミコンダクター株式会社

世界は「アナログ」でできている

あらゆるフィールドで活躍するトレックスの電源IC



**1**

**2025年3月期 第1四半期業績**

**2**

**2025年3月期 業績予想**

**3**

**株主還元**

**4**

**トピックス**

**Appendix**

▶ **トレックスは、日本、欧州市場の売上が減少し減収となったが、為替の影響と棚卸評価損の戻しが発生し、増益**

▶ **フェニテックは、アジア市場が回復、為替の影響もあり、増収増益**

▶ **2025年3月期の業績予想は、期初の予想から変更なし**

# 2025年3月期 第1四半期業績

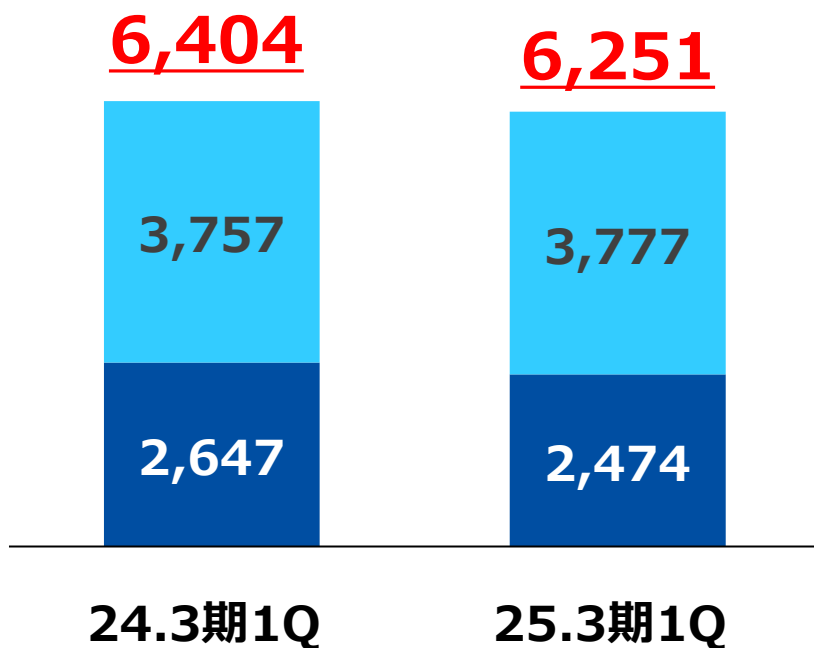
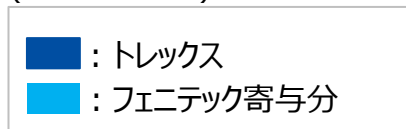


(単位：百万円)

	24.3期 1Q実績	25.3期 1Q実績	対前年同期比 増減率
売上高	6,404	6,251	▲2.4%
営業利益	222	365	64.1%
営業利益率	3.5%	5.8%	+2.3pt
経常利益	▲12	340	-
親会社株主に 帰属する四半期純利益	70	83	17.4%
EPS (円)	6.45	7.57	+1.12
海外売上高比率 (*1)	68.0%	70.6%	+2.6pt
平均為替レート (1\$=)	¥138.1	¥156.5	-
減価償却費	413	498	20.6%
設備投資	1,311	1,221	▲6.9%

(\*1)海外売上高比率：外貨建て売上比率

(単位：百万円)



## ➤ トレックス

- 中国市場は回復傾向にあるものの、日本・欧州市場の落ち込みにより減収
- 産業機器分野が減少

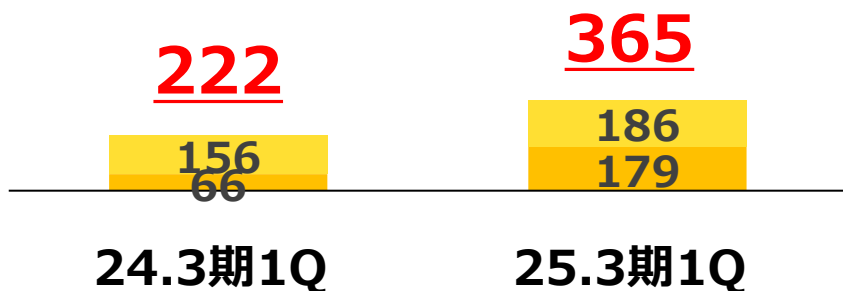
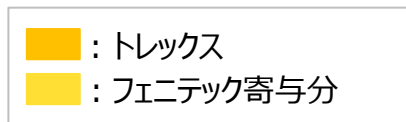
## ➤ フェニテック

- 北米市場は落ち込むも、中国市場の回復に伴い、若干の増収
- 一般民生機器などの分野が増加

(単位：百万円)

	24.3期1Q 実績	25.3期1Q 実績	対前年同期比増減率
売上高	6,404	6,251	▲2.4%

(単位：百万円)



## ➤ トレックス

- 為替の影響と棚卸評価損の戻りが発生し、増収

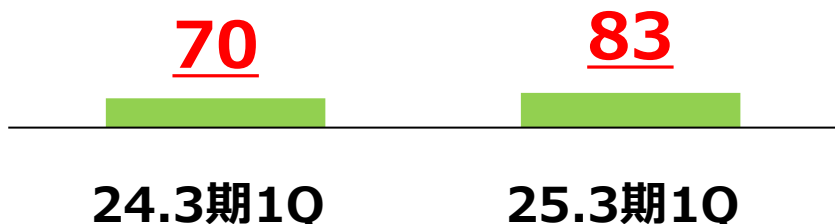
## ➤ フェニテック

- 為替の影響により増収

(単位：百万円)

	24.3期1Q 実績	25.3期1Q 実績	対前年同期比増減率
営業利益	222	365	64.1%

(単位：百万円)



営業利益の増加に加え、為替差損が減少したものの、法人税等の計算上税金費用が増加したため、微増

(単位：百万円)

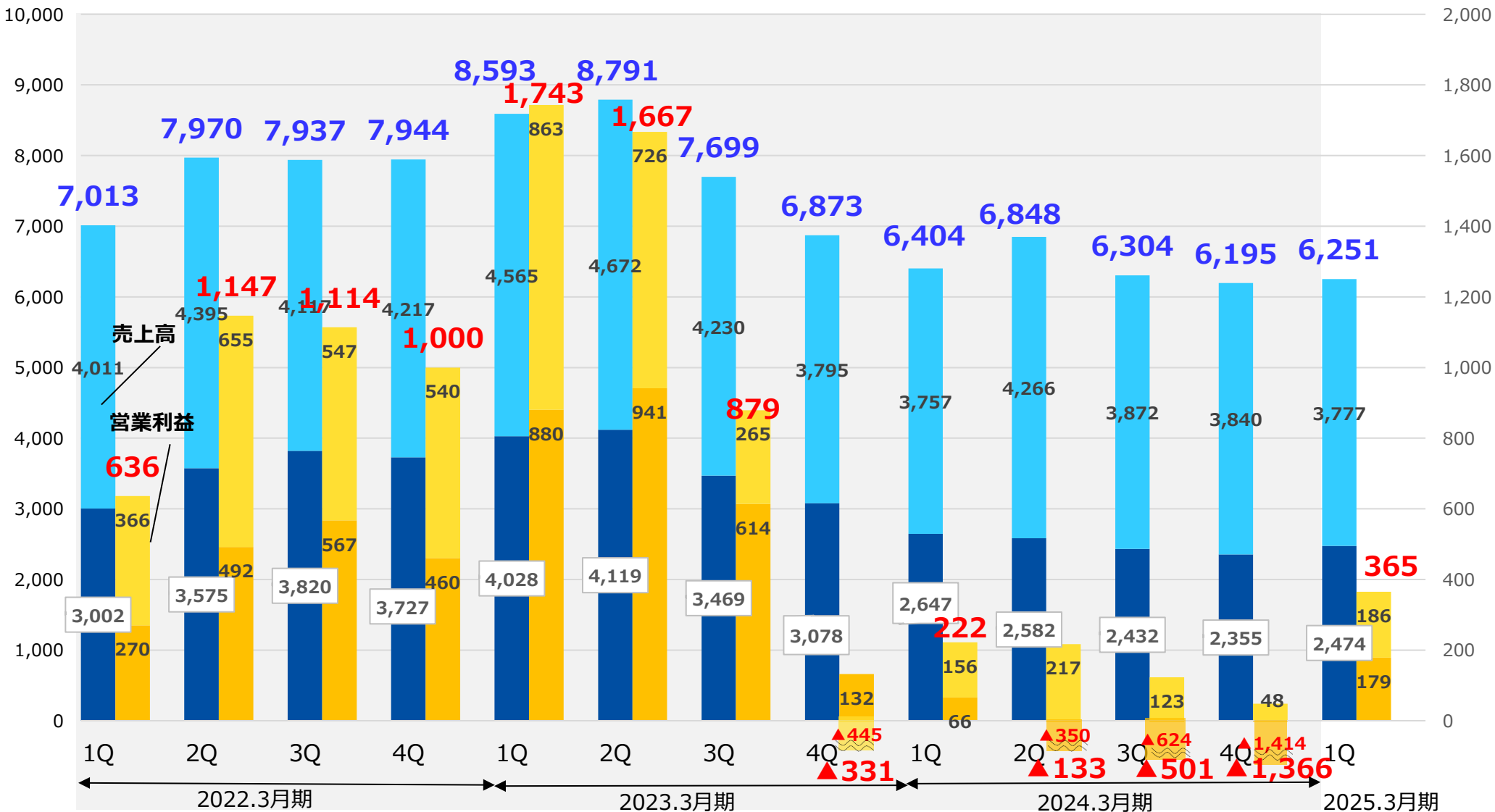
	24.3期1Q 実績	25.3期1Q 実績	対前年同期比増減率
四半期純利益	70	83	17.4%

# 売上高・営業利益の四半期推移



(左軸：売上高) トレックス : ■ ■  
 (単位：百万円) フェニテック : ■ ■

(右軸：営業利益)  
 (単位：百万円)



(単位：百万円)

	24年3月期末	25年3月期 1Q末	対前期末増減
資産	36,636	39,465	2,829
負債	16,083	18,766	2,683
純資産	20,552	20,699	147

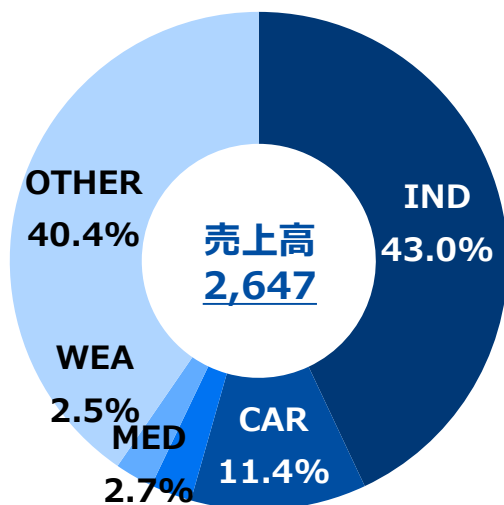
#### <参考> キャッシュ・フロー関連指標の推移

	24年3月期末	25年3月期 1Q末	対前期末増減
有利子負債	11,314	14,794	3,480
自己資本比率	56.1%	52.4%	▲3.7pt
D/Eレシオ	0.55	0.72	0.17pt

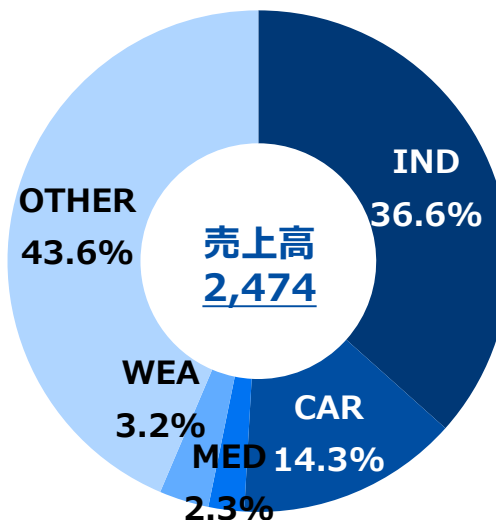
# トレックス／フェニテック 各単体

# 2025年3月期 第1四半期業績 ～アプリケーション別売上高（トレックス）：参考値

TOIREX



24.3期 1Q実績



25.3期 1Q実績

(単位：百万円)

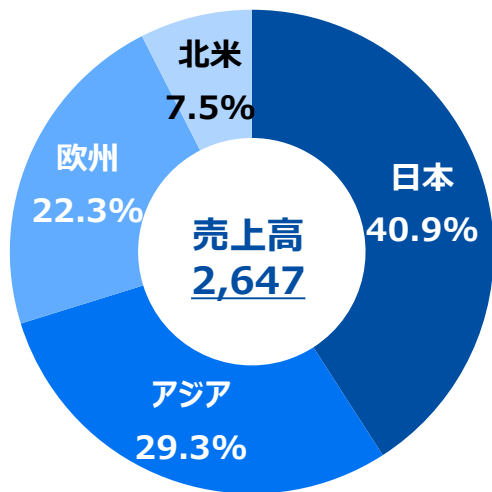
アプリケーション	24.3期 1Q		25.3期 1Q		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	1,139	43.0%	905	36.6%	▲20.5%
CAR 車載機器	302	11.4%	355	14.3%	17.5%
MED 医療機器	70	2.7%	56	2.3%	▲20.0%
WEA ウェアラブル機器	66	2.5%	78	3.2%	18.2%
OTHER その他機器	1,070	40.4%	1,080	43.6%	0.9%

※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。

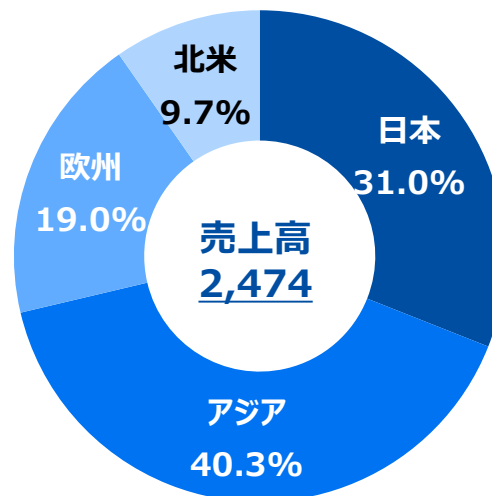


# 2025年3月期 第1四半期業績 ～地域別売上高（トレックス）

TOIREX



**24.3期 1Q実績**

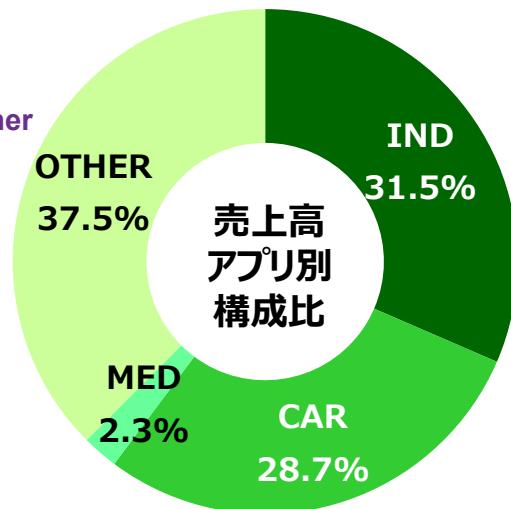


**25.3期 1Q実績**

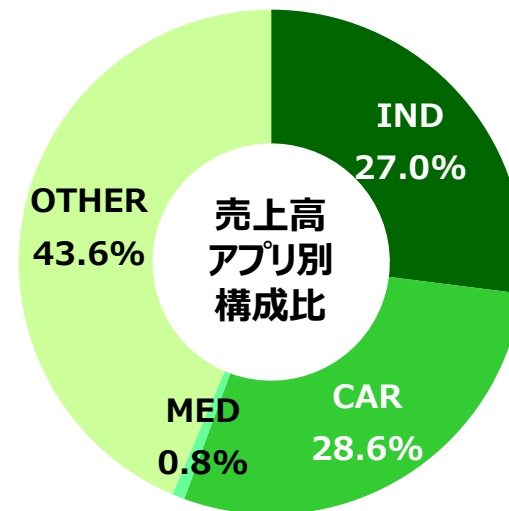
(単位：百万円)

地域 (D-in)	24.3期 1Q		25.3期 1Q		対前年同期比 増減率
	D-in 売上高	構成比	D-in 売上高	構成比	
日本	1,083	40.9%	767	31.0%	▲29.2%
アジア	775	29.3%	997	40.3%	28.6%
欧州	591	22.3%	470	19.0%	▲20.5%
北米	198	7.5%	240	9.7%	21.2%
平均為替レート (1\$=)	138.1円		156.5円		

D-in 売上高：デザイン・イン・ベース売上高。当社の製品を搭載した製品が企画・設計され、実質的に受注を獲得した地域をベースとした売上高



24.3期 1Q実績



25.3期 1Q実績

(単位：百万円)

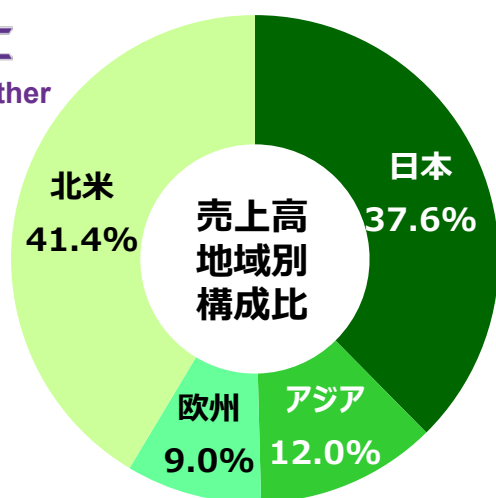
アプリケーション	24.3期 1Q		25.3期 1Q		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	1,269	31.5%	1,097	27%	▲13.6%
CAR 車載機器	1,156	28.7%	1,162	28.6%	0.5%
MED 医療機器	95	2.3%	31	0.8%	▲67.4%
OTHER その他機器	1,512	37.5%	1,769	43.6%	17.0%

※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。

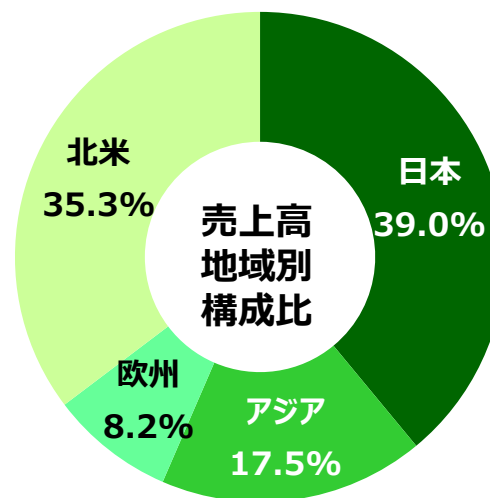
トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含みます。

お客様から用途を開示頂けない製品は、その他機器に含めております。

# 2025年3月期 第1四半期業績 ～地域別売上高（フェニテック）



24.3期 1Q実績



25.3期 1Q実績

※ 顧客の所在地別に区分しています。

(単位：百万円)

地域（顧客）	24.3期 1Q		25.3期 1Q		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
日本	1,517	37.6%	1,583	39.0%	4.4%
アジア	483	12.0%	711	17.5%	47.2%
欧州	364	9.0%	331	8.2%	▲9.1%
北米	1,668	41.4%	1,434	35.3%	▲14.0%
平均為替レート（1\$=）	138.1円		156.5円		

※注：日本には、トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

# 2025年3月期 業績予想

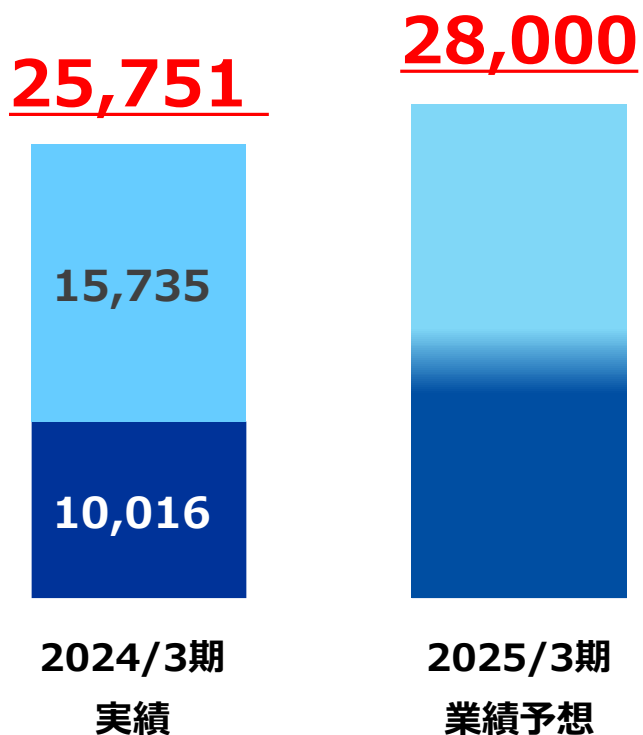
## 25年3月期の業績予想に変更はありません

(単位：百万円)

	24.3期 通期実績	25.3期 業績予想	対前年 同期比 増減率	備考
売上高	25,751	28,000	+8.7%	
営業損益	▲1,778	1,000	-	
営業利益率	-	3.6%	-	
経常損益	▲2,452	1,000	-	
親会社株主に 帰属する当期純損益	▲4,297	700	-	
EPS (円)	▲390.73	63.63	-	
平均為替レート (1\$=)	¥144.4	¥150.0	-	
減価償却費	2,350	3,000	+27.7%	
設備投資	5,284	3,600	▲31.9%	

(単位：百万円)

■ : トレックス  
 ■ : フェニテック寄与分



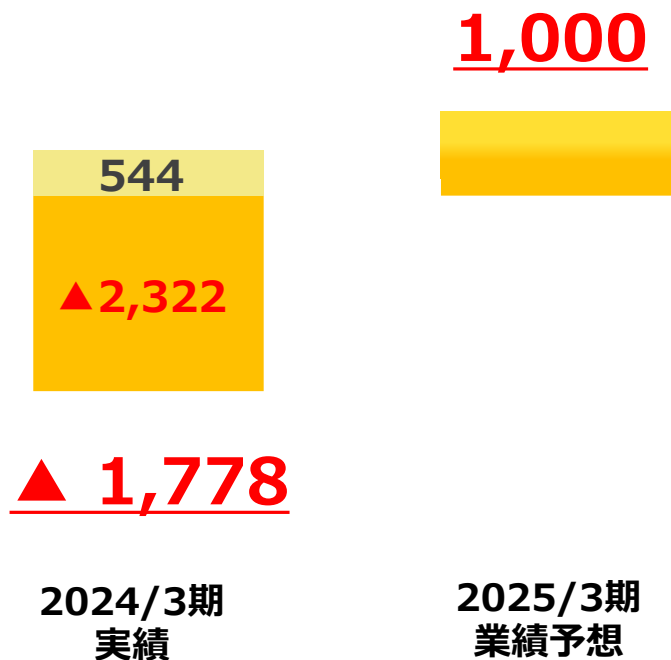
年後半からの半導体市況の回復を想定し、増収と予想

(単位：百万円)

	2024年3月期 実績	2025年3月期 業績予想	対前年増減率
売上高	25,751	28,000	+8.7%

(単位：百万円)

■ : トレックス  
 ■ : フェニテック寄与分



売上の増加と昨年発生したTRXにおける在庫の評価損の解消により大きく増加。

	2024年3月期 実績	2025年3月期 業績予想	対前年増減率
<b>営業損益</b>	<b>▲1,778</b>	<b>1,000</b>	<b>—</b>

# 株主還元

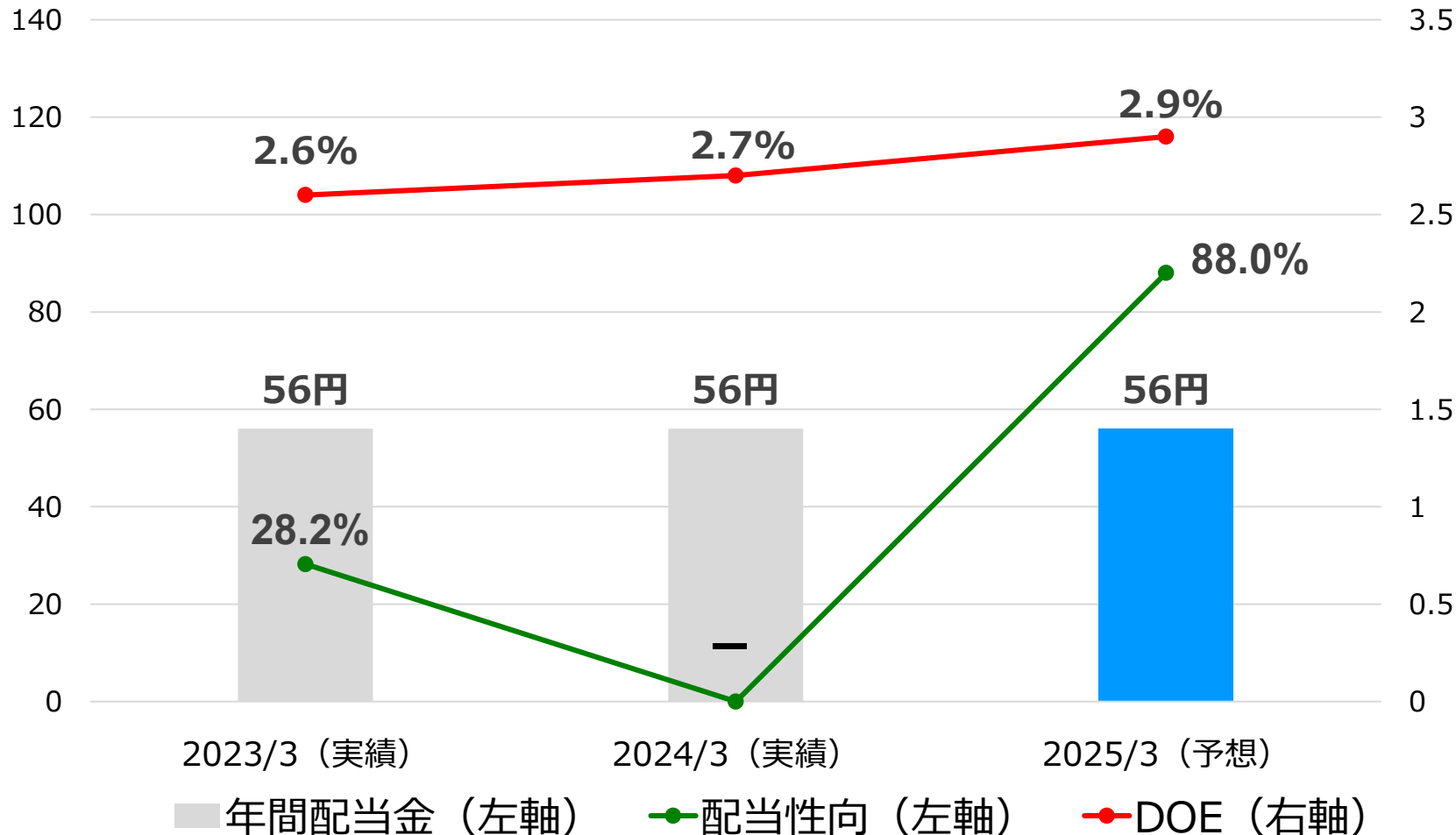


配当につきましては、業績水準を反映した利益配分として  
**連結配当性向20%以上**、安定的かつ継続的な株主還元  
の拡充として**株主資本配当率（D O E）3%程度**を当面  
の目標として実施しております。

## 連結配当性向20%以上、D O E 3%程度を目標として還元

配当金：円  
配当性向：%

DOE：%



# トピックス

# 2024年度 経営方針（抜粋）

技術基盤を持つ企業として、半導体市場での存在価値を一層高めていく為の活動を推進。

- **中高耐圧製品の早期ラインナップ（トレックス）**
  - 産業機器、車載に向けた 高性能／高品質 製品
  - DC/DCコンバータ、コイル一体型DC/DCコンバータ
- **パワーデバイスビジネス推進（フェニテック）**
  - オリジナル技術開発
  - SiCデバイス、Si（パワーMOSFET、IGBT）、酸化ガリウム

## PWM/PFM制御 60V高耐圧 300mA 降圧DC/DC XC9702 シリーズ

- PWM、PWM/PFM自動切換制御
- 同期整流 ドライバ FET内蔵
- 入力電圧範囲 4.5V ~ 60V
- HSOP-8N、USP-10B

### 製品の特長

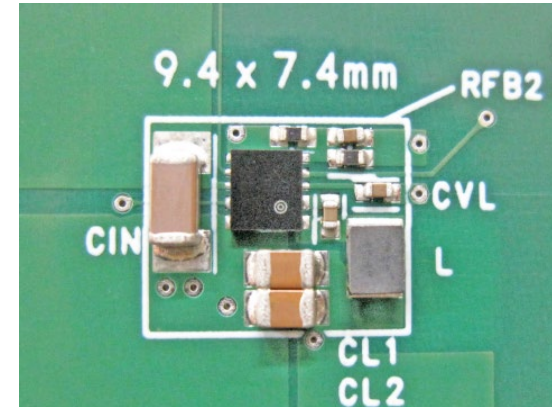
- 高効率、低リップル電圧
- 発信周波数：1MHz
- パワーグッド、UVLO 機能付
- サーマルシャットダウン、ショート保護
- インピーダンスやモーター等の負荷変動／誘導に対応

### ターゲットアプリケーション

12V/24Vラインからの高耐圧降圧

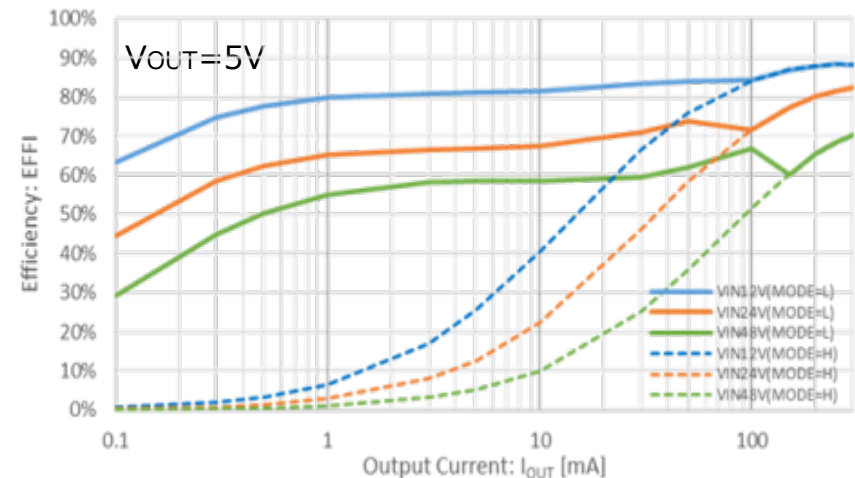
工場・ビル・施設などのセンサ／セキュリティ機器

FAの各種センサ



60V 300mA DC/DC  
世界最小クラスのソリューションサイズ

### 電力変換効率特性例



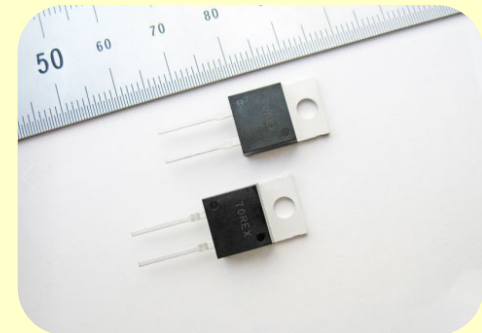
## ● トレックス 電源ICに加え、パワー半導体製品も強化

### パワー半導体事業拡大の専任組織を設置し、強かに推進

- ・ **MOS-FET**ラインナップ拡充（低V<sub>th</sub>製品、中耐圧大電流製品、低リーク）
- ・ **IGBT** 製品開発の検討
- ・ **SiC** 製品開発推進、製品の具体化
  - ⇒ **フェニテック製 SiC-SBD** トレックスよりPKG品サンプル提供中
  - ⇒ 順次、製品ラインナップを拡大
- ・ **酸化ガリウム**製品開発
  - ⇒ ノベルクリスタルテクノロジー社と共同開発

トレックスでは、フェニテックセミコンダクターが開発した、SiC ショットキーバリアダイオード 850V／10A品のサンプル提供を開始しました。

また、本製品を皮切りに順次 650V～1200Vの製品ラインナップ化を推進しております。



[SiC-SBD TO-220AC XBSC11A108CS](#)

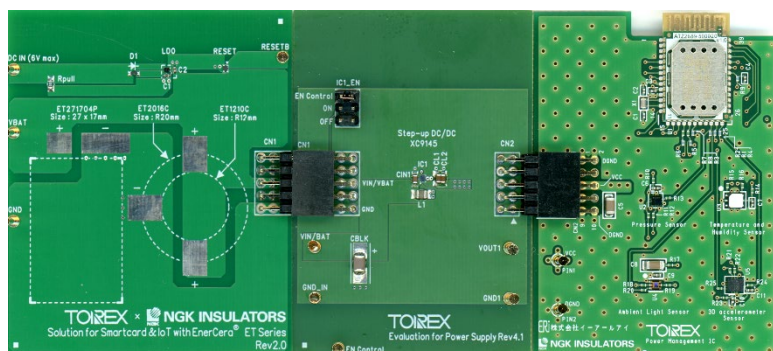
## 評価されているトレックス製品

## (株)イーアールアイ、日本ガイシ(株)、トレックス・セミコンダクター(株) 3社の技術を組み合わせ「環境発電デモボード」を2種開発

「環境発電デモボード EsBLE」は、

- ・ 日本ガイシの超薄型・小型リチウムイオン二次電池「EnerCera®(エナセラ)」
- ・ トレックスの超低消費電源IC
- ・ イーアールアイの低消費無線化技術

を組み合わせたボードとなっており、太陽光パネル、振動発電などのエネルギーハーベストで発電した電力にて温湿度、気圧などを測定し、BLE(Bluetooth LE)で送信することが可能です。



EsBLE TYPE1

ハーベストから電池への充電基板、超低消費高効率電源基板、測定、通信、制御のシステム基板に別れており、様々な仕様での検証が可能です。



EsBLE TYPE2

必要な機能をすべて実装したオールインワンボードとなります。エネルギーハーベストを接続するだけで、各種センサーでの測定とBLEでのデータ送信が可能です。



## トレックスの電源ICは、省電力/小型のスペックが評価されています。

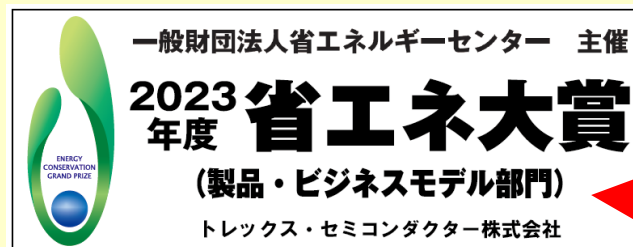
### 2023年度



日刊工業新聞主催

**XC9145シリーズ**：昇圧DC/DCコンバータ回路の消費電流を400nAまで低減したPWM/PFM制御方式を採用することで、軽負荷時、特に数 $\mu$ Aの出力電流における電力効率を50~60%改善しました。

奨励賞  
受賞



審査委員会  
特別賞受賞

**XC8110/8111シリーズ**：ロードスイッチIC理想的なダイオードを再現し、チップイネーブル(CE)、過電流制限、突入電流制限、サーマルシャットダウン機能等を搭載したロードスイッチICです。

### 2022年度



日刊工業新聞主催

**XC8110/8111シリーズ**  
ロードスイッチIC

### 2020年度



省エネルギーセンター主催

**XC9276シリーズ**  
DC/DCコンバータ

### 2019年度



日刊工業新聞主催

**XC9281/XC9282シリーズ**  
DC/DCコンバータ

### 2018年度



経済産業省主催

**XC9265シリーズ**  
DC/DCコンバータ

### 2018年度



日刊工業新聞主催

**XC6192シリーズ**  
ロードスイッチIC

# フェニテックセミコンダクター

## New Vision

### 2024年1月 ビジョンの刷新

ファウンドリ事業を通じ  
すべてのステークホルダーから信頼されることにより  
持続的成長を目指します

For Further Growth Together

#### ファウンドリ事業

半導体前工程のウェハプロセス專業のファウンドリ事業を軸・強みとして事業展開を進めていきます。

#### ステークホルダー

ステークホルダーを、顧客・取引先・社員・株主・地域社会の人々等、私たちに関連するすべての人や団体と定義します。

#### 信頼

会社として個人として、ステークホルダーと相互に信頼関係にあるパートナーとなることを目指します。

#### 持続的成長

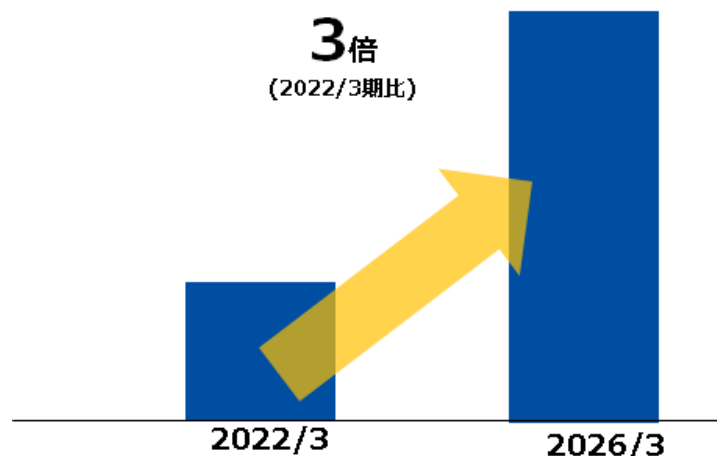
信頼をベースに、ステークホルダーと共に持続的に成長していく企業を目指します。

## トレックス メインFABの一つとして鹿児島工場生産能力増強

- ・ アナログ電源IC 生産能力増強
- ・ 生産能力増強に関わる設備投資  
3年計画 23.3期~25.3期 総額44億円  
**(25.3期 投資計画最終年度 10億円を計画)**
- ・ 順次 生産装置を搬入 稼働に向けて立上げ中

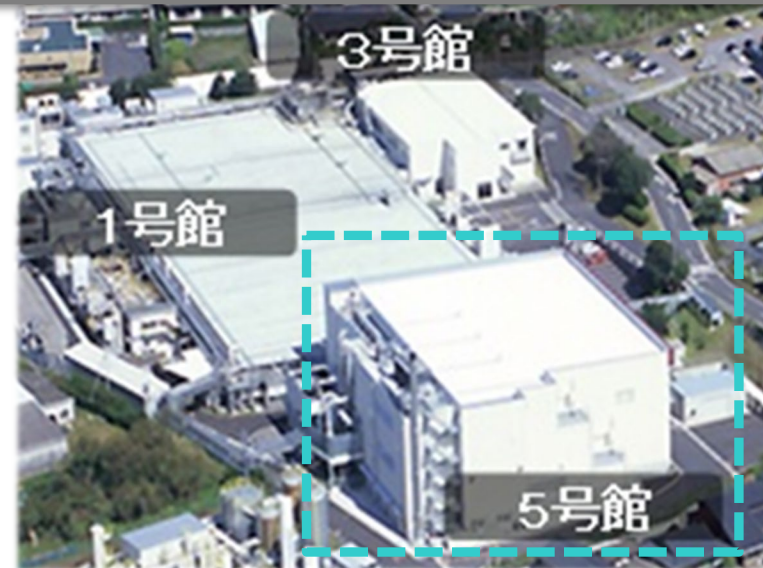


### トレックス製品 生産能力枚数推移



**トレックス製品の長期安定供給を実現**

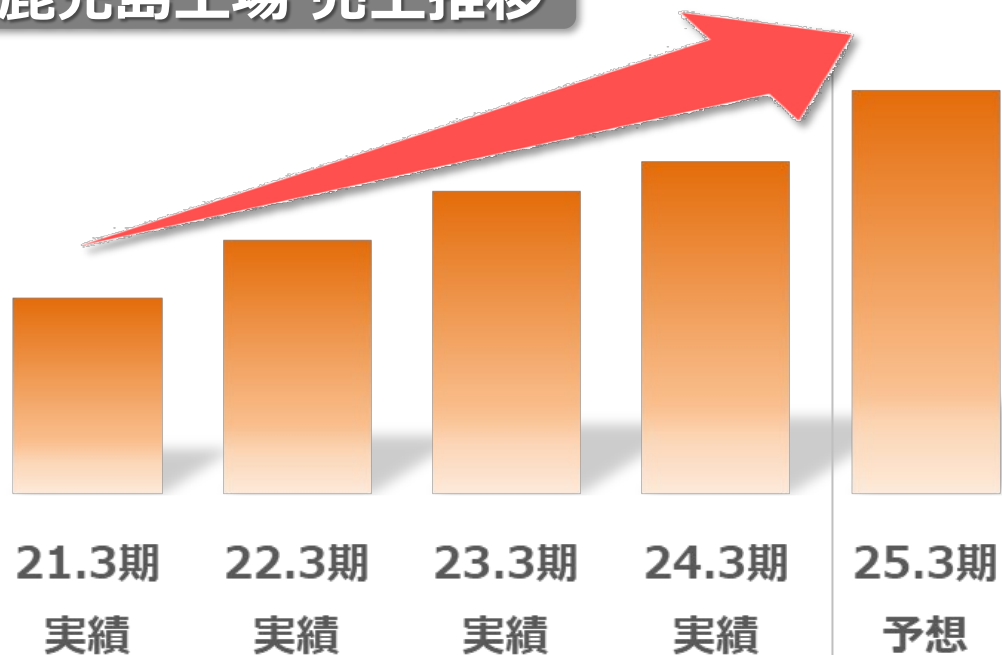
### 鹿児島工場5号館3階をクリーンルーム化



## 鹿児島工場の取組み

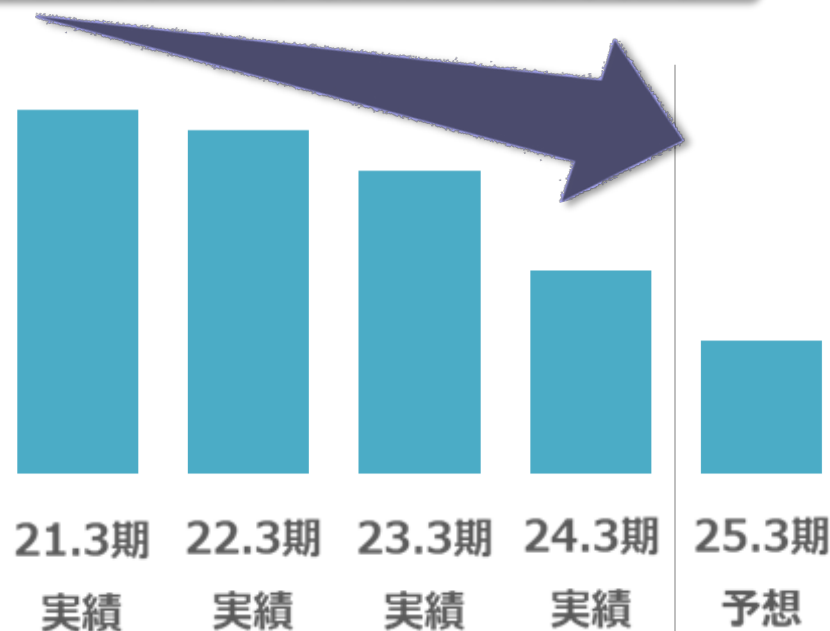
- ✓ 事業計画達成に向けた生産能力増強
- ✓ 製造固定費削減による安定した収益の確保
  - ・組織体制の改善
  - ・消耗品、修繕、消費電力削減
  - ・労働生産性向上によるCT短縮

### 鹿児島工場 売上推移



**25.3期 2万枚/月 安定した生産体制へ**

### 売上高に対する固定費比率推移



**製造コスト削減により固定費比率低下**

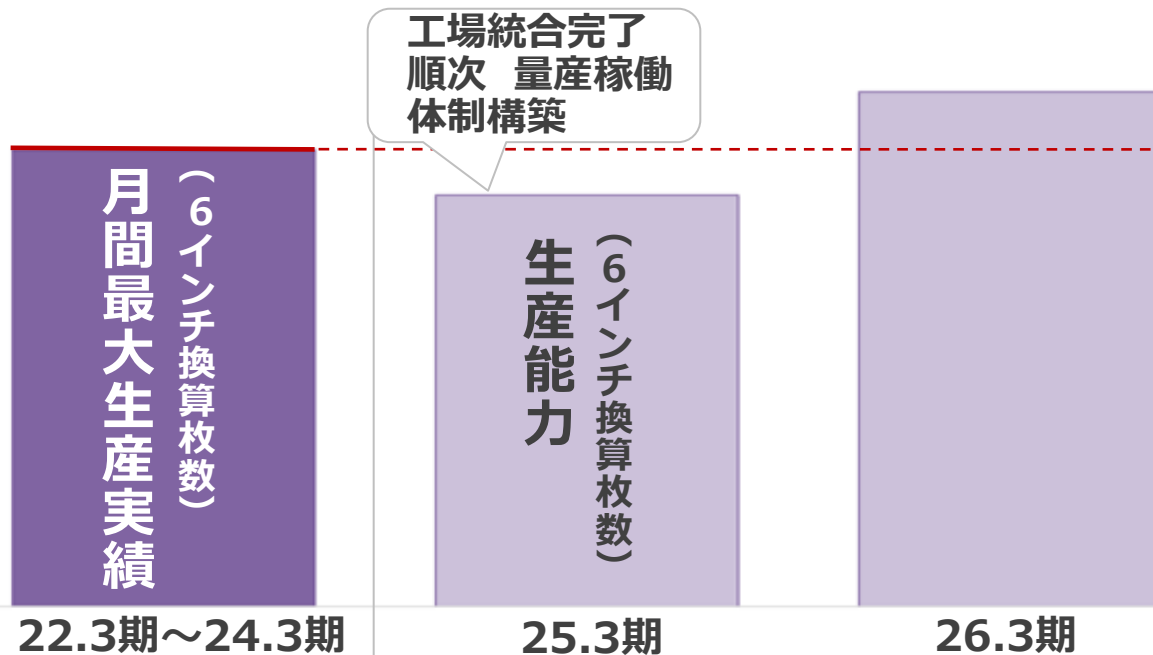


## 岡山工場の取組み

- ✓ 第2工場 Siデバイスの生産を終え、第1工場に集約し量産稼働体制構築
- ✓ 既存装置の生産性を追求
  - ・交替勤務体制変更により働き方改革の実現と設備稼働率向上を目指す
  - ・固定費・変動費削減を追求

## 岡山工場 生産実績/生産能力推移

工場統合に伴いインチサイズアップすることで生産能力を拡大



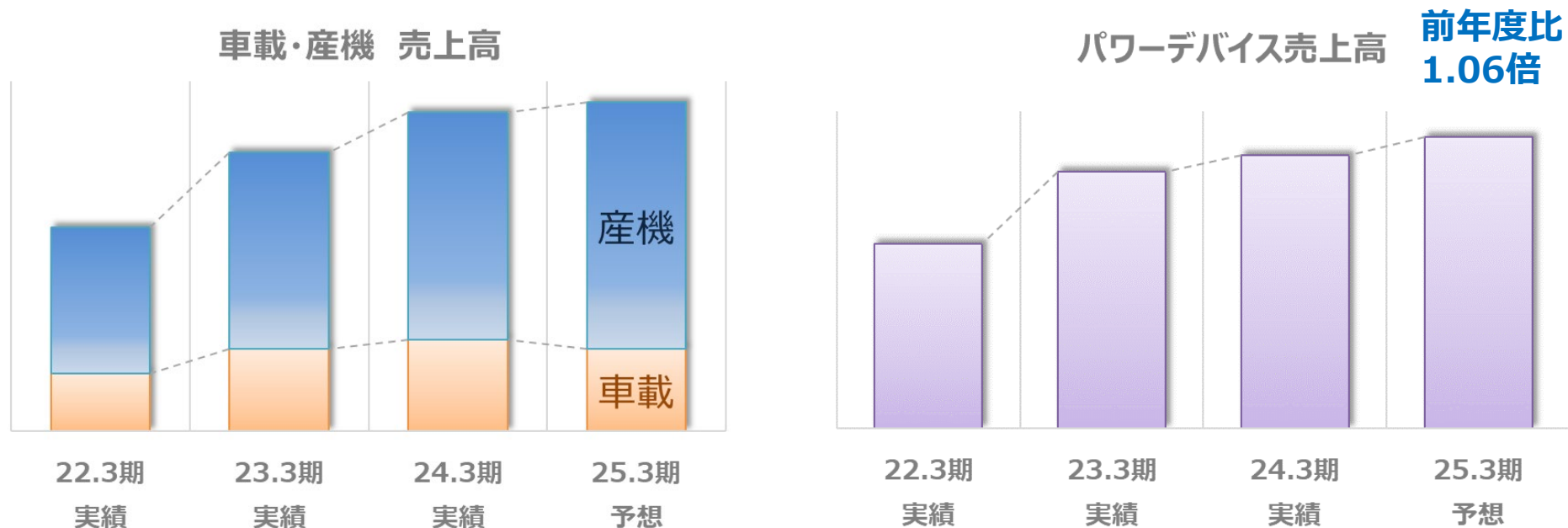
## 岡山第1工場



## Siパワーデバイスの受注は引き続き高水準を維持

要因：自動車の電動化、産業機器、5G、新エネルギーなどの需要好調

デバイス：IGBT、MOSFET、SBD



## 化合物半導体材料に対応したプロセス技術開発 パワー半導体供給ニーズに応える

取扱い：炭化ケイ素 (SiC)、酸化ガリウム (Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)、窒化ガリウム (GaN)

✓市場要求に応えるパワー半導体の開発により更なる売上アップを目指す

## Siパワーデバイス開発計画

24.3期

25.3期

26.3期

27.3期

新たなパワーデバイス開発により更なる売上アップを目指す

### ★ Low Vth MOSFET 量産中

- ・医療系、産業系など高密度実装機器をターゲットに低電圧駆動（1.5V以下）製品を開発
- ・ラインナップ拡充中

### ★ スプリットゲート型MOSFET

- ・非常に低オン抵抗を実現し、より小さなパッケージで高い電流密度を実現(電池の長寿命化等貢献)
- ・試作評価中



### ★ フィールドストップ型IGBT

- ・高入カインピーダンス、高いスイッチング速度、高耐圧且つ低オン抵抗素子フィールドストップIGBTの先端性能を目指した開発
- ・25.3期Q4量産予定

シナジー効果

トレックス・フェニテックはパワー半導体を共同企画・開発 このモジュール開発には、当社のパワー半導体生産技術が多分に活かされます

### ★ ハイパフォーマンス ショットキーバリアダイオード

- ・デバイス構造の変更により、VF/IRのトレードオフを大幅に改善
- ・リーク電流を抑えることで、ジャンクション温度150℃保証が可能に
- ・25.3期Q4量産予定



## SiCオリジナル品

SBD

650V 10A Gen.2,3

650V 6,8,10A Gen.4

650V 20A Gen.2,3

1200V 10A Gen.2,3

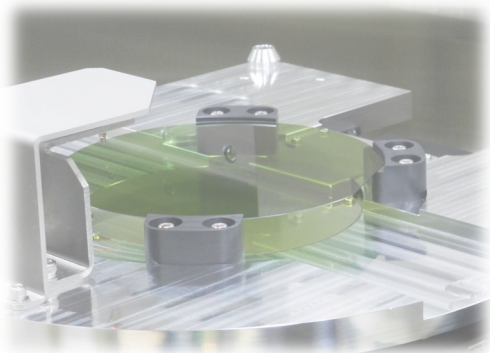
✓ 今後も市場要望にスピーディなシリーズ拡充で対応

・第2,3世代 サンプル提供中/顧客評価中

MOS FET

1200V 20A Planar/Trench

- ・プレーナー型 設計完了/サンプル作成開始  
サンプル提供 25.3期Q3予定
- ・トレンチ型 開発中



当社設計オリジナル品SBDは  
開発を終え、  
**量産フェーズへ移行しました**

## SiCファウンドリ事業

MOSFET

- ・ファウンドリ品を量産中
- ・新規顧客開拓中

➤ オリジナル品、ファウンドリ品の生産による相乗効果で  
付加価値の高い製品・ウエハ加工技術を提供します

## 広島大学 ナノデバイス研究所 Jイノベ HUB棟建設支援

当社は、せとうち半導体共創コンソーシアムに参画  
企業版ふるさと納税を利用し、ナノデバイス研究所  
Jイノベ HUB棟建設に支援を行いました

### 広島大学 ナノデバイス研究所 東棟



ナノデバイス研究所 東棟に当社看板が設置されました

### 紺綬褒章 受章



支援に対して 紺綬褒章 を拝受いたしました

### Jイノベ HUB棟ロビー



デザイン看板に当社ロゴが入りました



**第39回ネプコン ジャパン**  
- エレクトロニクス開発・実装展 -

**第2回 パワーデバイス&モジュール EXPO**

**次回 ネプコン ジャパン パワーデバイス&モジュール EXPO に出展**

- ✓ パワーデバイス ファウンドリ会社としての知名度向上
- ✓ 自社開発のパワーデバイス開発製品紹介
- ✓ ファウンドリビジネス紹介

大変好評を得た 前回の初出展を受けて、次回ネプコン ジャパンに、ブース規模を拡大して出展いたします

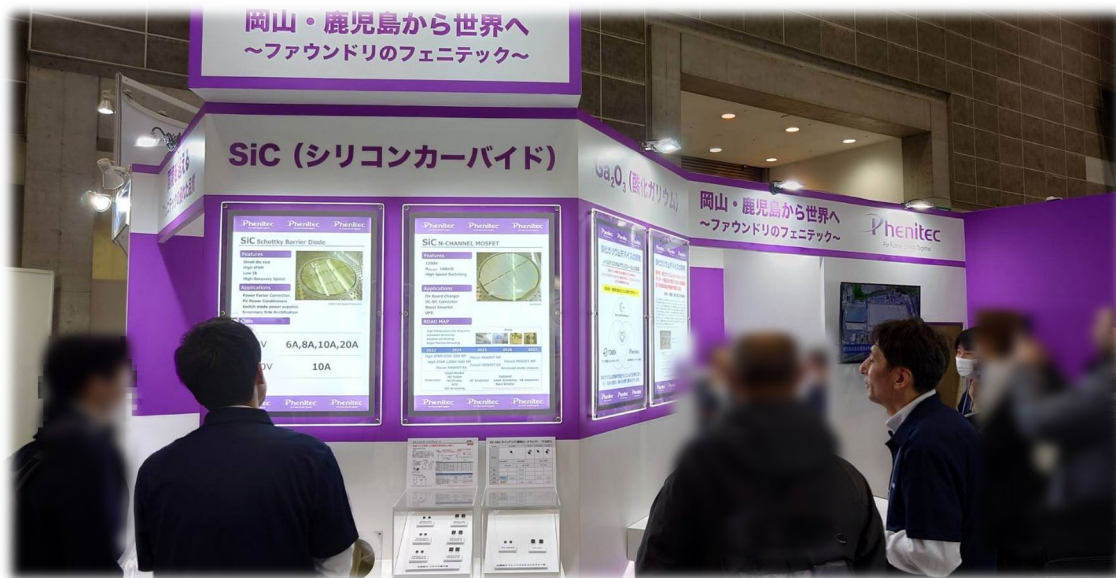
**開催日**

2025年1月22日(水)~24日(金)

**会場**

東京ビッグサイト 東7ホール

**皆様のお越しを心よりお待ちしております**



前回出展時 当社ブースの様子



前回出展ブース 展示品の様子

2024.7

## 岡山工場 近隣小学生児童と保護者を対象とした工場見学会を開催

交流を通して、地域の子供達と保護者の方々に半導体と当社を知っていただく良き場となりました。当社は、この会により、ご参加いただいた子供達に半導体に対する知的好奇心が芽生え、将来半導体産業に関わっていく、きっかけになってくれればと期待しています。

### 企画名

「井原おしごと探検ツアー」

### 開催日

2024年7月30日(火)

### 対象

小学4～6年生児童及び保護者  
(岡山県井原市在学)

### 主催

井原市・井原市教育委員会  
井原市商工会議所



2024.2

## 岡山大学 大学院単位認定講座 & 社会人向け公開講座 「先端半導体テクノロジー」講演

半導体に関連する最新の先端技術をカバーするための、専門家ゲスト講師として、当社担当者が登壇しました。

当社の半導体の経済安全保障上の重要性、これからの半導体産業の成長性などを紹介。半導体人材育成に貢献させていただきました。

✓ 今後も開講が予定されていますが、当社も引き続き貢献してまいります。

### 「産」と「学」の連携の推進について

<<深みと幅のある教育の取組>>

理論・学術  
に強み

教育現場



- ・出前授業
- ・研修/インターンシップ
- ・工場見学

シミュレーション  
仮説検証

マッチングによる産と学の協働教育  
教育の充実



実体験/現場  
に強み

企業



- ・人的支援
- ・実体験（教育環境）、  
の場、教材の提供



当社担当講師 講演の様子

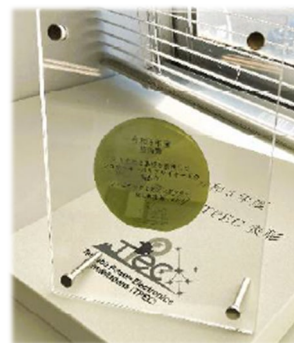
✓ 産学官連携して人材育成プログラム及び人材確保実行プランを推進していきます。



2023.12

## 当社が国立研究開発法人産業技術総合研究所から「TPEC技術賞」を受賞

この賞は産業技術総合研究所で共同研究をしている企業の中から優れた開発を行い、それをビジネスにつなげる事ができた成果を表彰するものです。当社は、共同研究の開発技術を用いて、貼り合せ基板を使用したショットキーバリアダイオードの製品化を成し遂げました。



2024.1

## 電子デバイス産業新聞主催セミナー「SiCとGaN 半導体ビジネス最前線」に登壇

来場・オンライン参加を含め国内外から数多くの方が参加がある中、当社のSiC事業「SiCパワー半導体のファウンドリ戦略」を紹介しました。



# Appendix 会社紹介

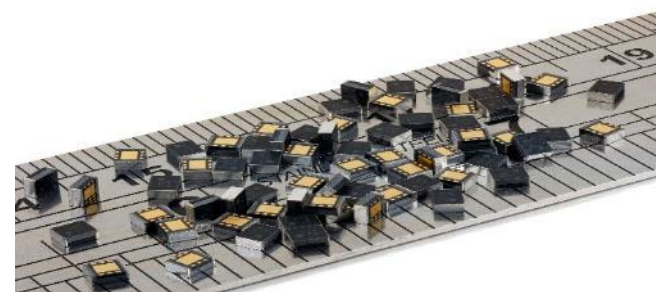
1995年に設立。2014年にJASDAQスタンダード市場に上場、東証二部、一部を経て、2022年4月に東証プライム市場に移行した半導体メーカーです。

アナログのチカラ

ABOUT TOREX

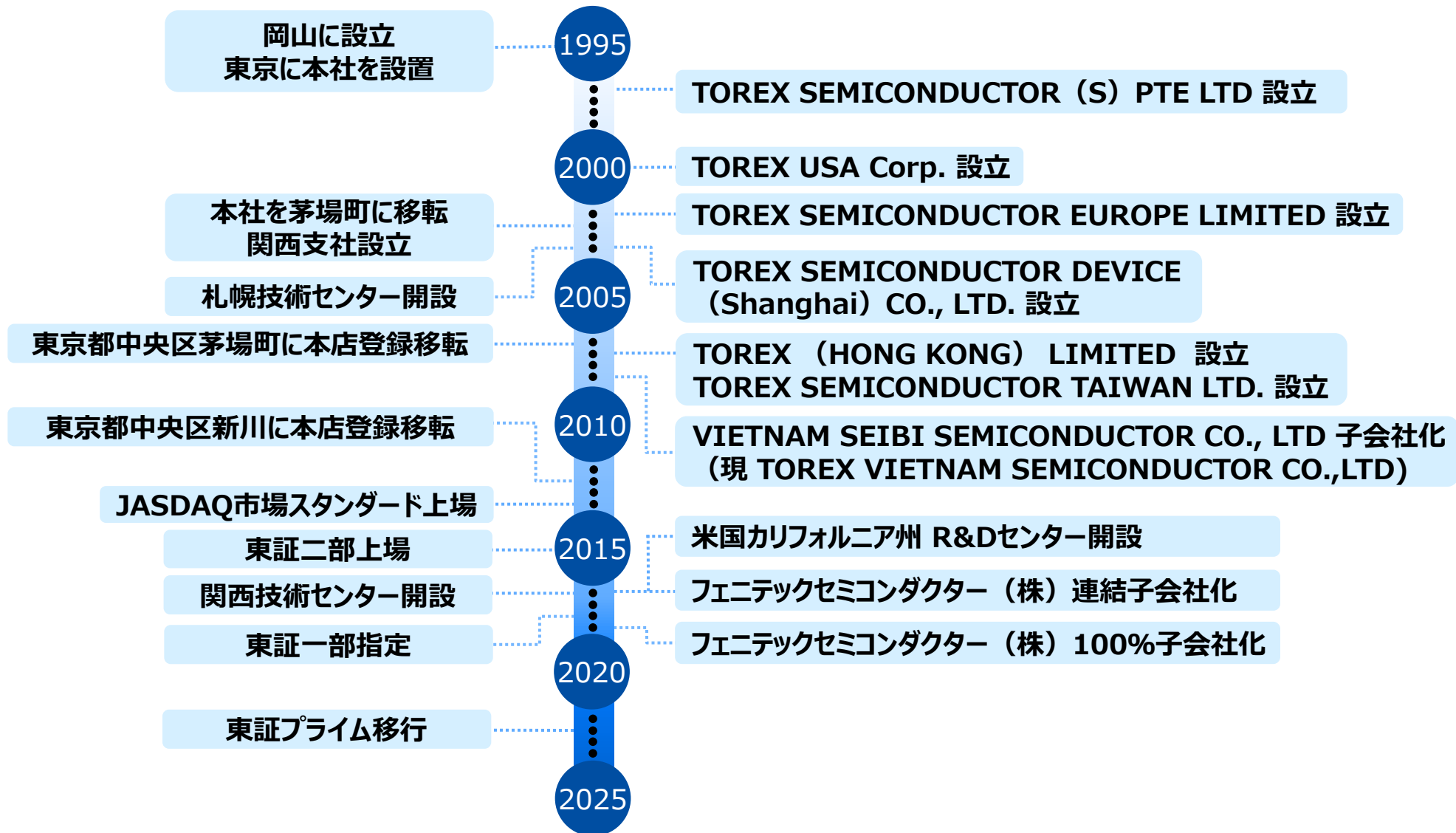
所在地	東京都中央区新川1-24-1 DAIHO ANNEX 3F
代表者	代表取締役社長 木村 岳史
資本金	29億6793万円（2024年6月30日現在）
事業内容	1.半導体デバイスの開発、設計製造 2.半導体デバイスの販売
従業員数	当社：190名 / グループ：1,053名
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場
単元株式数	100株
決算期	3月末日
証券コード	6616
URL	<a href="https://www.torex.co.jp/">https://www.torex.co.jp/</a>

常に豊かな知性と感性を磨き、市場に適応した価値ある製品を創出し、豊かな社会の実現と地球環境の保全に貢献するとともに、私たちの事業に携わるすべての人々が共に繁栄することを企業の理念とする。





電源IC一筋、**省電力・小型化**の技術でエレクトロニクス産業の発展に貢献してきました。



TOIREX



## トレックス・ セミコンダクター

**ファブレスメーカー  
アナログ電源IC専業**

強み

- ・省電力／小型化の技術
- ・蓄積されたアナログ回路ノウハウ
- ・マーケティングと製品企画力
- ・フレキシブルな生産工場
- ・高品質をキープするQC
- ・ワールドワイドの製品販売網

Phenitex  
For Further Growth Together



## フェニテック セミコンダクター

**半導体受託専業(ファウンドリ)  
ディスクリート、パワーデバイス、  
CMOSアナログプロセス**

強み

- ・高品質を支える生産ノウハウ
- ・長期安定供給のJapanFab
- ・車載 IATF16949取得工場
- ・専門性の高い製造対応力
- ・オリジナルデバイスの開発力
- ・パワーデバイスの開発力



## トレックス・ セミコンダクター グループ

- ・顧客第一に徹した、小回りの利く対応力
- ・積極的なコラボレーションやM&Aによる協力関係の構築

**ファブレス&ファウンドリ  
それぞれが本業を突き詰めたプロ集団となり、  
相互補完でシナジーを発揮する。**

- 国内に東京本社を含む 8 拠点、海外に9つの拠点を設け、世界の需要に対応しています。



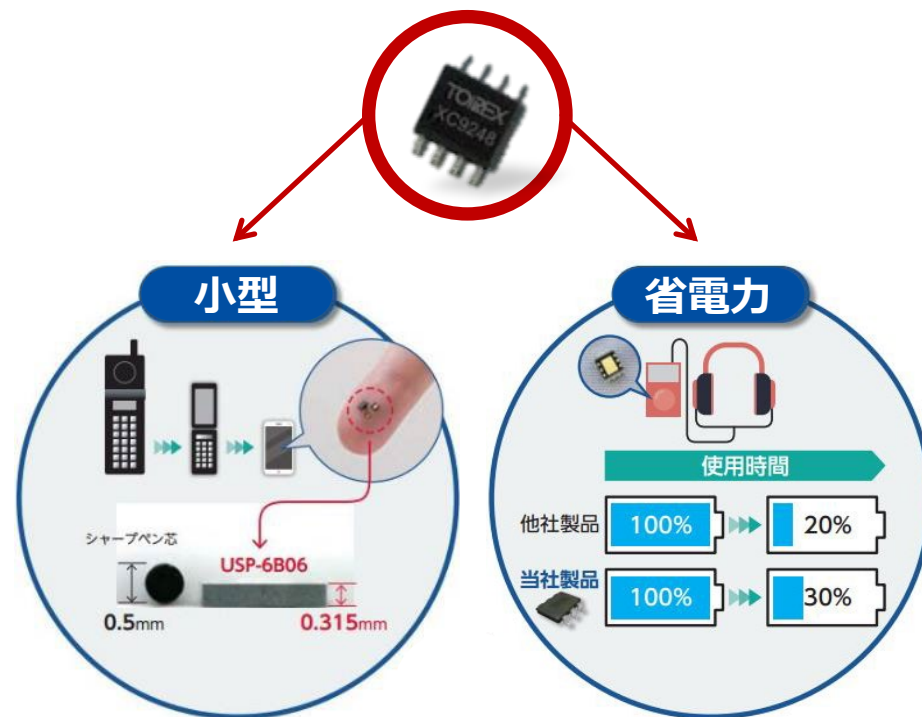
- 世界トップクラスの小型・省電力電源ICを開発・販売しています。

## 電源ICの役割



電子機器の様々な機能を動かすために  
電圧を制御し安定供給する

## TOIREXの電源IC



独自の技術で電子機器の  
小型化、省電力化に貢献

	トレックス・セミコンダクター	フェニテックセミコンダクター
事業形態	ファブレス	ファウンドリ
主な製品	<p style="background-color: #FFD700; text-align: center; padding: 5px;"><b>省エネに貢献するキーデバイスを提供</b></p> <p><b>電源IC</b></p>	<p><b>ディスクリート パワー半導体 (SiC、GaN、酸化ガリウム)</b></p>
今後の重点市場	<p><b>産業機器</b> 5G、IoTモジュール 全固体電池モジュール</p> <p><b>車載機器</b> 自動運転、ADAS、車載カメラ 電子ミラー他、様々なECU</p>	<p><b>産業機器</b> 産業用ロボット、鉄道、インバータ 発電施設（風力・太陽光）、パワーコンディショナー</p> <p><b>車載機器</b> EV向けパワー半導体 電装品</p>



**5G**



**IoT**



**自動運転**



**EV**

**本資料に記載された内容は、2024年8月9日現在において一般的に入手可能な情報と、合理的と判断する一定の前提に基づき、当社が作成したものです。**

**本資料に記載されている当社の中期計画、見通し等に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。**

**実際の業績は、これらの要素により本資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。**

**投資に関するご決定をされる際、本資料のみに全面的に依拠することはお控えいただき、みなさまご自身のご判断でなされるようお願い致します。**



# Powerfully Small!

常に豊かな知性と感性を磨き、  
市場に適応した価値ある製品を創出し、  
豊かな社会の実現と  
地球環境の保全に貢献するとともに、  
私たちの事業に携わるすべての人々が  
共に繁栄すること

